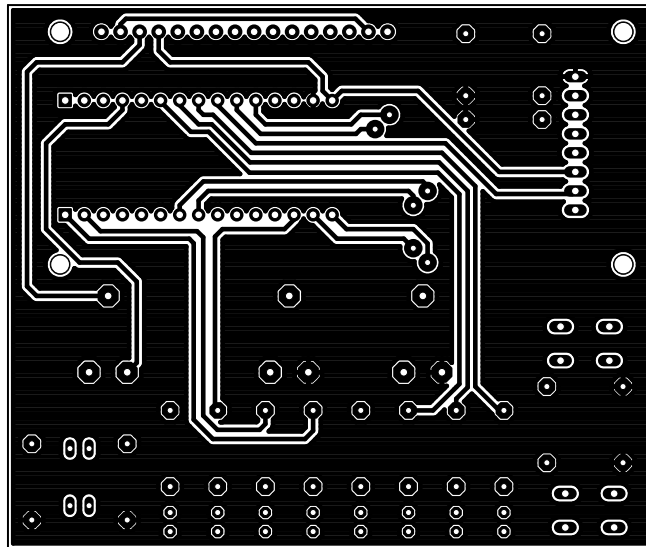
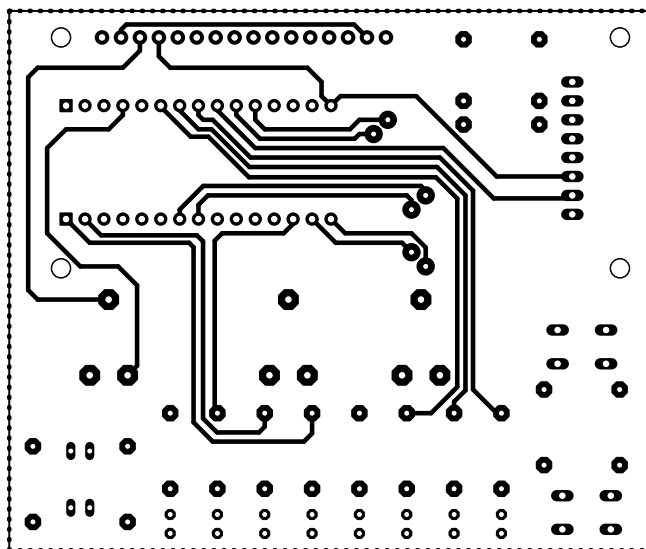


Dossier de fabrication

IUT de Montpellier	Dépt GEII	Groupe :
KITSTM32 JIPADA 2021		Auteur : Dépt GEII
		Date : 02/2022

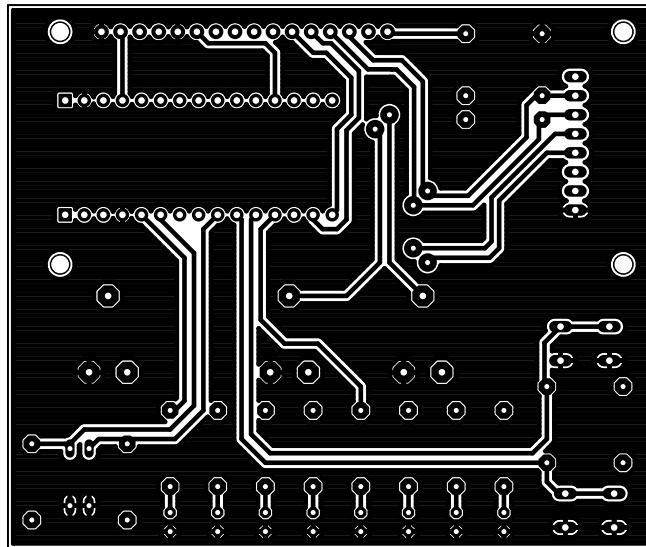


TOP avec plan de masse

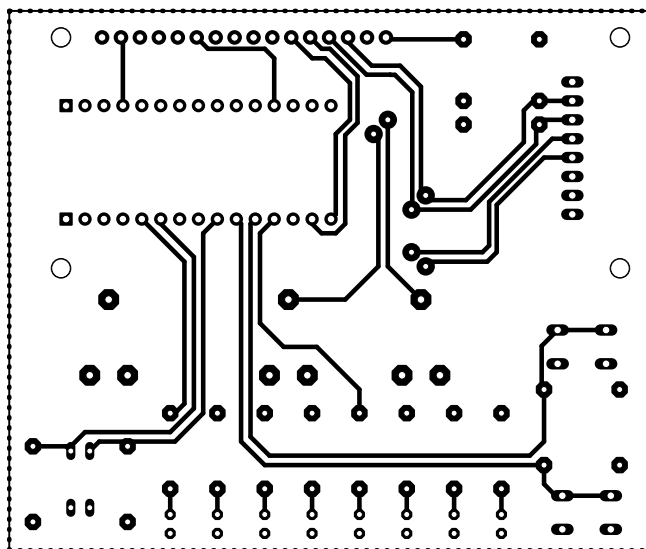


TOP sans plan de masse

IUT de Montpellier	Dépt GEII	Groupe :
KITSTM32 JIPADA 2021		Auteur : Dépt GEII
TYPON TOP AVEC ET SANS PLAN DE MASSE		Date : 02/2022

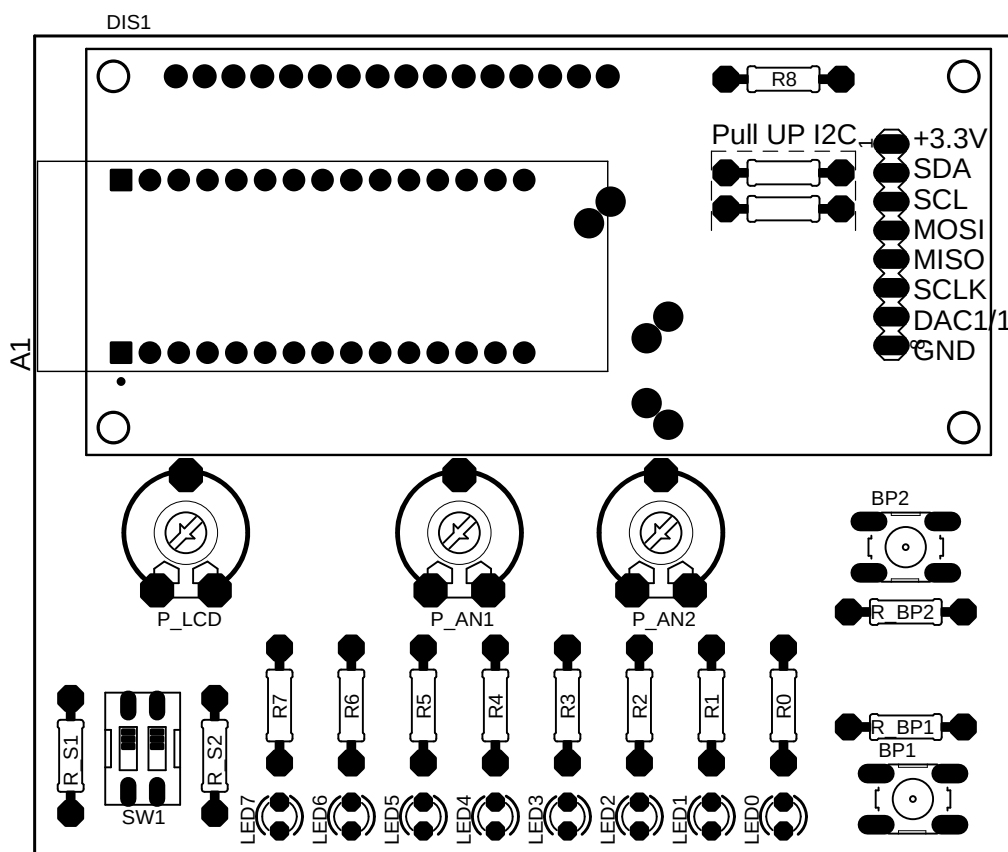


BOTTOM avec plan de masse



BOTTOM sans plan de masse

IUT de Montpellier	Dépt GEII	Groupe :
KITSTM32 JIPADA 2021		Auteur : Dépt GEII
TYPON BOTTOM AVEC ET SANS PLAN DE MASSE		Date : 02/2022



IUT de Montpellier	Dépt GEII	Groupe :
KITSTM32 JIPADA 2021		Auteur : Dépt GEII
IMPLANTATION DES COMPOSANTS		Date : 02/2022

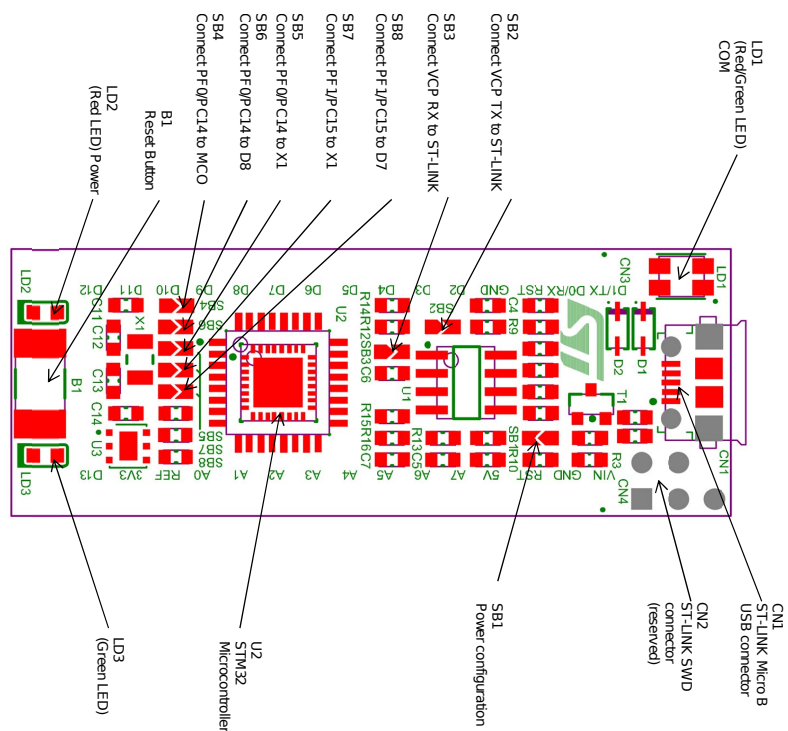
Repère	Quantité	Valeur	Désignation (puissance, techno, etc)	Boitier (référence)
BP1	2		OMRON SWITCH	
LEDx	8		LED3MM	
SV1	1		Connecteur mâle coudé 8 broches	
R_UP_xxx	2		RES_1/4W	
SW1	1		DIP_SWITCH	
R_BP _x /R_S _x	4	10k	RES_1/4W	
R0 - R8	9	330	RES_1/4W	
P_AN _x /LCD	3	50k	Résistance variable	
A1	1		NUCLEO-F303K8	
A1	2		15P FEMELLE AMP QUICK CONNECTOR	
DIS1	1		Pour LCD display 16x2	
DIS1	1		16P FEMELLE AMP QUICK CONNECTORTUXGR_16X2.R2	
IUT de Montpellier			Dépt GEII	Groupe :
KITSTM32 JIPADA 2021				Auteur : Dépt GEII
NOMENCLATURE				Date : 02/2022

PROCÉDURE DE FABRICATION

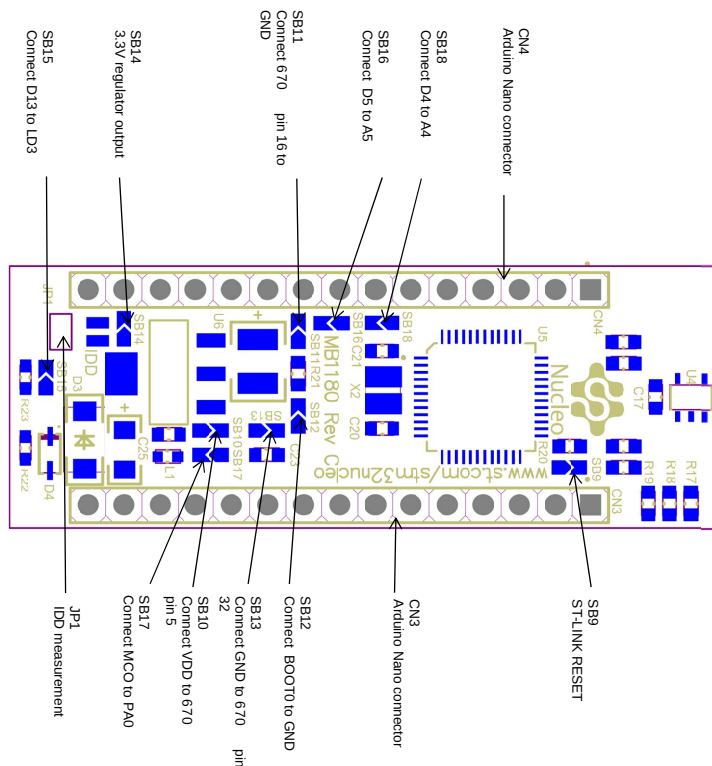
- Contrôle qualité PCB, examen visuel
- Test électrique isolement VCC et GND (ohmmètre)
- Test continuité des masses. Prendre en plusieurs points : cathode LED, GND de la carte STM32F303K8, connecteurs, poussoir,...
- Souder dans le bon ordre les composants (du plus fin au plus épais)
- Tester à nouveau les continuités et les isolements des VCC et GND
- Tester les LED (alim 5V+R ou multimètre en testeur de diode)
- Il est nécessaire de supprimer les 2 solder bridges suivants sur la carte STM32F303K8 et STM32L031K6 (voir annexe suivante) :
 - SB16
 - SB18
- Il est nécessaire d'apporter les modifications sur les 4 solder bridges suivants sur la carte STM32L031K6 (**et uniquement elle**) pour pouvoir utiliser les broches PF0 et PF1 (voir annexe suivante) :
 - Supprimer SB5 et SB7
 - Souder SB6
 - Souder SB8
- Implanter¹ le programme JIPADA_LED.bin pour tester les LED. (In chenillard we trust !)
- Implanter le programme JIPADA_SW_BP.bin pour tester les dipswitch et les poussoirs.
- Implanter le programme JIPADA_POT.bin pour tester les entrées analogiques et le convertisseur analogique numérique avec les potentiomètres.
- Implanter le programme JIPADA_LCD.bin pour tester l'afficheur LCD.
- Implanter le programme JIPADA_DAC.bin pour tester le convertisseur numérique analogique (**uniquement pour la STM32F303K8**).

1. Pour implanter un programme il suffit de déposer le fichier .bin dans le lecteur qui est créé au moment où on branche la carte sur l'ordinateur

IUT de Montpellier	Dépt GEII	Groupe :
KITSTM32 JIPADA 2021		Auteur : Dépt GEII
PROCÉDURE FABRICATION		Date : 02/2022

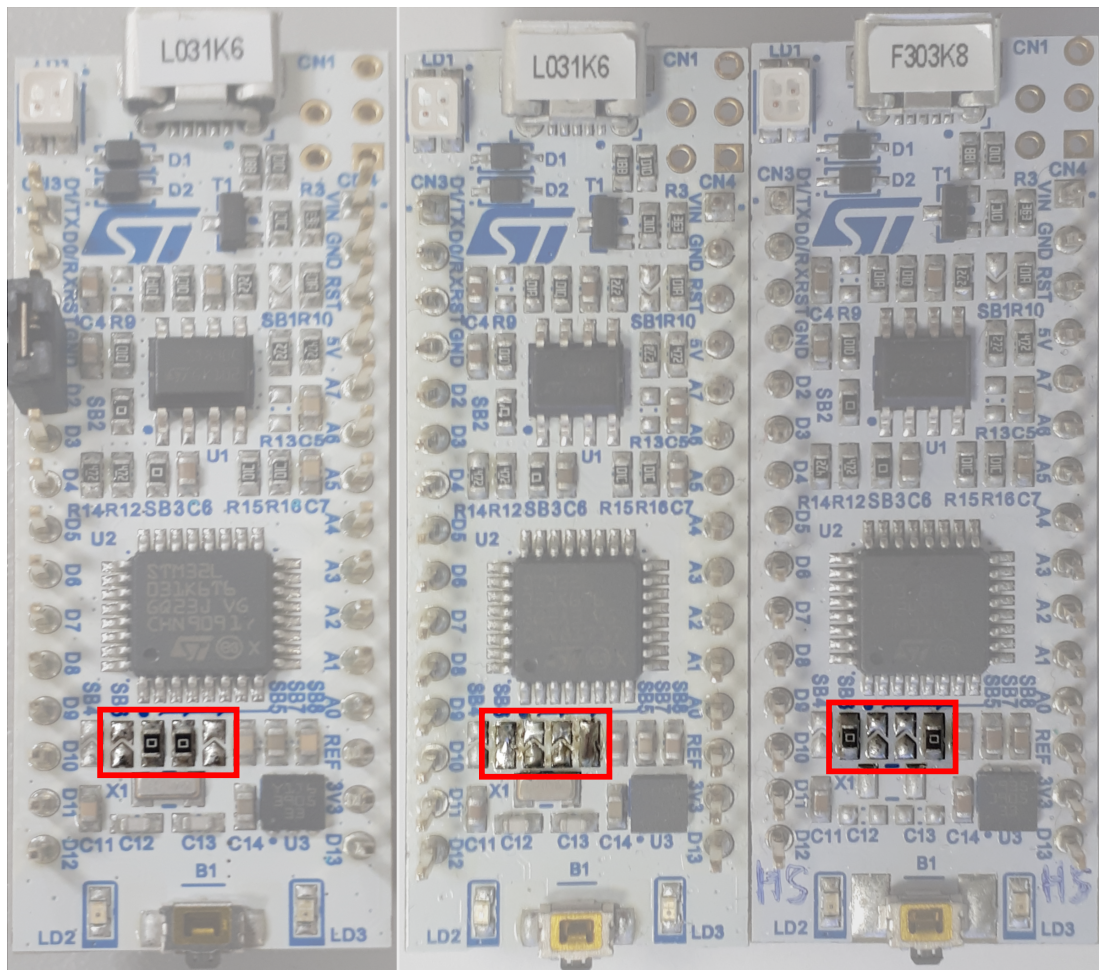


STM32 Nucleo-32 board top layout



STM32 Nucleo-32 board bottom layout

IUT de Montpellier	Dépt GEII	Groupe :
KITSTM32 JIPADA 2021		Auteur : Dépt GEII
SOLDER BRIDGES SUR F303K8 ET L031K6		Date : 02/2022



L031K6 d'origine

L031K6 avec solder
bridges *déplacés*

F303 d'origine

IUT de Montpellier	Dépt GEII	Groupe :
KITSTM32 JIPADA 2021		Auteur : Dépt GEII
SOLDER BRIDGES SUR F303K8 ET L031K6		Date : 02/2022